

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2021-013

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议案无需提交股东大会审议，现将募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2335 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 26.97 元，应募集资金总额为 566,370,000.00 元，扣除发行费用 60,625,896.22 元（不含增值税），实际募集资金净额为 505,744,103.78 元。以上募集资金已于 2019 年 12 月 10 日到位，募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2019]8294 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2019 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《沈阳芯源微电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额计划投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额	预计达到可使用状态日期	已投入费用	已投入费用占总计划投入费用比例
1	高端晶圆处理设备产业化项目	23,860.73	23,860.73	2021年6月10日	4,572.37	19.16%
2	高端晶圆处理设备研发中心项目	13,918.24	13,918.24	2020年10月10日	6,214.31	44.65%
合计		37,778.97	37,778.97	/	/	/

注：上表“已投入费用”为截至2020年12月31日的统计数据。

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-012）。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	高端晶圆处理设备产业化项目	2021年6月10日	2022年6月30日
2	高端晶圆处理设备研发中心项目	2020年10月10日	2022年3月31日

（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“高端晶圆处理设备产业化项目”原计划建设周期 18 个月，于 2021 年 6 月 10 日前达到预定可使用状态。受到沈阳市地下铁路修建规划的影响，“高端晶圆处理设备产业化项目”原规划地点拟进行地下铁路修建，不再具备进行募投项目建设的条件，公司于 2020 年 4 月 24 日变更了该项目的实施地点，由“沈阳市浑南区新岛街 6 号”变更为“沈阳市浑南区东至沈本一街，南至规划地块，西至沈本大街，北至桃园一路”，履行了必要的审批程序。在募投项目实施地点变更等因素的影响下，“高端晶圆处理设备产业化项目”的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 6 月 30 日。

公司募投项目“高端晶圆处理设备研发中心项目”原计划建设周期 10 个月，于 2020 年 10 月 10 日前达到预定可使用状态。由于受到国外新冠疫情、中美贸易战等因素的影响，“高端晶圆处理设备研发中心项目”所需的部分进口设备和材料无法正常、及时供应，该项目的设备采购以及安装调试工作有所延缓，研发项目开展情况不及预期。为提高募投资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日。

四、重新论证募投项目

公司募投项目“高端晶圆处理设备研发中心项目”原计划于 2020 年 10 月 10 日前达到预定可使用状态。截至 2020 年 10 月 10 日，该项目募集资金投入金额为 4,093.08 万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此公司对“高端晶圆处理设备研发中心项目”进行了重新论证：

1、项目建设的必要性

(1) 优化产品结构，增强高端装备设计能力

作为国内半导体专用设备行业的重要参与者，公司生产的光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备广泛应用于国内 LED 芯片制造和集成电路后道先进封装

领域，作为主流机型已成功打入包括台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌等在内的多家国内知名一线大厂。在保持现有市场优势地位的前提下，公司积极开拓集成电路制造前道晶圆加工领域市场，不断优化现有产品结构，开发出的前道产品已在下游知名芯片制造厂商进行工艺验证。通过募投项目的实施，公司将进一步加快前道产品的工艺技术提升，完善公司现有产品结构；公司将引进行业领先的国内外先进智能检测设备，有利于提升前道芯片制造领域产品的设计和研发能力，保持市场竞争优势地位。

（2）加大自主创新研发力度，助力高端半导体装备国产化进程

近年来，我国在半导体领域取得了较快发展，已成为全球最大的半导体消费市场。但也应看到，我国半导体设备的国产化程度仍然较低，特别是在前道设备领域，我国目前还主要依赖国外进口。通过募投项目的实施，有助于公司掌握更为先进的设备制造及成套工艺技术，从而弥补我国该领域设备市场的空白，推进高端半导体专用设备国产化进程，提升我国半导体产业的整体竞争力。

2、项目可行性分析

（1）国家政策支持行业发展

公司所处半导体设备行业是国家产业政策鼓励和重点支持发展的行业。近年来，为推动半导体产业的发展，进一步促进国民经济持续、快速、健康发展，我国先后出台《科技部重点支持集成电路重点专项》、《集成电路产业“十三五”发展规划》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》等鼓励和支持半导体设备产业发展的政策，为我国半导体设备行业发展营造了良好的政策环境。

（2）良好的市场前景

随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。根据 SEMI 预测报告，2020 年半导体设备的全球销售额达到 689 亿美元，同比增长 16%（2019 年销售额为 598 亿美元），创下新纪录。随着全球半导体制造设备市场在 2021 年和 2022 年分别达到 719 亿美元和 761 亿美元，这一增长有望持续。随着全球半导体产能不断向我国大陆地区转移，国际大厂纷纷在我国大陆地区投资建厂，同时在集成电

路产业投资基金的引导下，我国大陆集成电路生产线建设热情高涨，我国大陆地区对半导体设备的需求巨大。

（3）优质的客户积累

公司依托于持续的技术创新、高性价比的产品、快速的响应及优质的售后服务能力不断发展壮大，在细分领域已建立一定的行业知名度。

公司生产的前道涂胶显影设备通过在客户端的验证与改进，在多个关键技术方面取得突破，技术成果已应用到新产品中。报告期内，该类设备陆续获得了上海华力、中芯绍兴、厦门士兰集科、上海积塔、株洲中车、青岛芯恩、中芯宁波、昆明京东方等多个前道大客户订单及应用。

公司生产的前道清洗机 Spin Scrubber 设备目前已经达到国际先进水平，成功实现进口替代，已在中芯国际、上海华力、厦门士兰集科等多个客户处通过工艺验证，并在报告期内获得国内多家 Fab 厂商的批量重复订单。

公司生产的涂胶显影设备与单片式湿法设备，已经从先进封装领域、LED 领域拓展到 MEMS、化合物、功率器件、特种工艺等领域，作为主流机型应用于台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电、乾照光电、澳洋顺昌、中芯绍兴、中芯宁波等国内一线大厂。

此外，公司还通过加入行业协会、参加国内外展会等形式进一步扩大市场影响力，不断开拓新客户。

（4）丰富的技术储备

公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研究开发，引进了多名具有国际化视野与海外科研背景的行业专家加盟公司或担任公司技术顾问，建立了一支在半导体专用设备领域具有丰富研发经验的科研团队，具备较强的持续创新能力。经过多年发展及承担包括 02 重大专项等在内的科研项目，公司成功突破了前道芯片制程领域 300mm 晶圆涂胶显影设备核心关键技术，通过与客户的交流以及对市场主流光刻机技术的研究，结合终端工艺验证情况对现有前道产品持续研发升级，不断提升并完善现有技术储备。为进一步提高研发效率、激发创新活力，公司还制定了一整套研发管理制度，为募投的顺利实施提供制度保障。

3、募投项目经济效益测算

公司“高端晶圆处理设备研发中心项目”系研发项目，不直接产生经济效益，不适用募投项目经济效率测算。通过本项目的实施，能够全面支撑公司战略规划，扩大市场规模，提升公司竞争力。

4、募集资金投资项目重新论证的结论

公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，独立董事认为：“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于公司募投项目延期的议案》。”

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：“公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。”

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：“本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。”

七、上网公告附件

（一）沈阳芯源微电子设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；

（二）国信证券股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2021年3月20日